

本社移転のご挨拶

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます
さて この度 弊社は本社事務所を下記のとおり移転する運びとなりましたので
謹んでご案内申し上げます
尚 6月に発表致しましたユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション
との経営統合につきましては 統合準備が整い次第別途ご連絡致します
今後とも倍旧のご厚誼を賜りますようお願い申し上げます
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

敬 具

平成30年12月吉日

三重富士通セミコンダクター株式会社
代表取締役社長 河野 通有

記

- 【移 転 先】 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜13階
- 【代 表 電 話】 045-620-2682
- 【業 務 開 始 日】 平成31年1月7日（月）
- 【交通アクセス】 JR線、東急線、京浜急行線、みなとみらい線、相鉄線
横浜駅（きた東口A）より徒歩5分

